

中国材料研究学会

中国材料大会 2026 暨第 27 届中国国际新材料博览会

邀请函

尊敬的_____先生/女士:

中国材料大会 2026 将于 2026 年 7 月 14-17 日在湖北省 武汉市 武汉国际博览中心召开。会议由中国材料研究学会发起并主办。会议主要内容如下:

一、分论坛设置

A-能源材料

A01-能源转换与存储材料

A02-高熵能源催化材料

A03-核材料

A04-太阳能材料与器件

A05-油气田及新能源材料

A06-纳米材料合成及光/电催化应用

A07-有机/钙钛矿太阳能电池材料

A08-水系电池及关键材料

A09-极端合成与新材料

A10-钠离子电池材料

A11-固态电池及关键材料

A12-先进分离膜与多孔材料

A13-AI+先进能源材料与器件前沿

A14-AI 驱动能源材料化学与化工协同创新

B-环境材料

B01-光催化材料

B02-生态环境材料

B03-环境功能材料

B04-资源材料与循环利用

B05-环境分离净化材料与技术

B08-矿物功能材料

C-结构材料

C01-粉末冶金

C02-高性能铝合金

C03-镁及镁合金	D08-纳米多孔金属材料
C04-高温合金	D09-纤维材料改性与复合技术
C05-高性能钛合金材料	D10-高分子材料
C06-金属基复合材料	D11-电子材料与微系统
C07-空间材料科学技术	D12-先进磁性功能材料
C08-超高温结构材料与防护涂层	D13-水凝胶材料
C09-先进结构陶瓷的制备与表征	D14-碳点功能材料
C10-微结构与强韧化	D15-先进涂料
C11-冲击环境材料技术	D16-微纳能源器件及关键材料
C12-兵器材料科学与技术	D17-智能传感功能材料与器件
C13-先进钢铁材料	D18-仿生材料
C14-结构材料热-动力学	D19-液态金属材料
C15-水泥与混凝土材料	D20-多孔吸附与催化
C16-极端环境材料特种制备与性能	D21-多尺度结晶光电材料及器件
C17-核石墨	D23-磁流体-磁流变
C18-先进粉末冶金材料与技术	D24-功能分子材料与器件
C19-难熔金属分会	D25-纳米信息功能材料
D-功能材料	D26-智能分子材料
D01-超材料与多功能材料	D27-二维材料与器件
D02-多铁性材料	D28-电化学功能材料
D03-非晶与高熵合金	D29-多孔材料制备及应用
D04-刺激响应功能材料	D30-先进半导体光电材料与器件
D05-纤维素工程与技术	D31-先进电工材料关键技术及应用
D06-先进微电子与光电子材料	D32-润滑密封与耐磨材料
D07-生物医用材料	D33-原子级制造与智能传感

D34-功能薄膜
D35-含能材料
D36-热管理材料
D37-运动健康新材料
D38-无机光电功能材料
D39-超导材料与应用
D40-柔性电子材料与器件分会
D41-类脑计算材料与器件分论坛
D42-电磁屏蔽与吸收材料
D43-人工晶体生长与器件应用
D44-量子材料
D45-超晶格
D46-超分子材料
D47-核酸功能材料
D49-石墨炔可控合成、理论及应用
D50-关键金属
D51-碳基材料
D52-精准诊疗关键材料
D53-智能医药材料与器件
D54-极端条件下材料与器件
破
D55-纳米材料与器件
E-材料模拟、制备与评价
E01-材料先进制备加工技术
E02-材料界面/表面分析与表征

E03-相分离冶金与材料
E04-先进凝固科学与技术
E05-材料微结构加工与先进合金化技术
E06-材料基因与人工智能
E07-增材制造材料
E08-超声材料科学与技术
E09-材料表面工程
E10-材料结构与性能表征技术
E11-中子源与同步辐射先进材料表征技术
E12-人工智能化学与材料学
E14-先进催化材料与技术
E15-微细加工与成形及晶体塑性力学应用
E17-相场理论与应用
P-高分子材料老化与服役寿命研究
Z-材料模拟、计算与设计
FB-前沿热点青年论坛
FA01-青托、青培材料论坛暨第四届青托党校
FB01-材料介观方法青年科学家论坛
FB02-新体系电池青年科学家论坛
FB03-低维轻元素材料与器件青年科学家论坛

FB04-先进材料连接与焊接科学青年 科学家论坛	FC02-AI+结构材料高级研修班
FB05-青年科学家非共识论坛	FC03-AI+功能材料高级研修班
FB06-人工智能与物质科学青年科学 家论坛	FC04-学术论文与基金写作能力提升 班
FB07-后摩尔新出路	FC05-文化遗产材料分论坛
FB08-青年学者前沿闪报大讲台	FC06-科普夏令营
FC-特色材料论坛	FC08-新概念材料与前沿交叉科学发 展 2050 高层论坛
FC01-2026 知名高校材料院长论坛	

二、注册费标准与支付

（一）注册费标准（不含版面费）

类别	2026 年 6 月 23 日 17:00 前缴费	2026 年 6 月 23 日 17:00-7 月 13 日缴费	2026 年 7 月 14-17 日现场缴费
学生	1000 元	1500 元	1800 元
非学生	2000 元	2500 元	2800 元

备注：

1. 优惠截止日期前注册且选择现场缴费，但未缴费的参会代表不享受注册费优惠政策。

2. 会议期间，食宿统一安排，费用自理。

（二）注册费缴纳

1. 扫码支付（推荐）

参会代表登录大会官网，注册后进行在线支付，可选择支付宝、微信、银联等在线支付方式。

2. 汇款支付（推荐）

参会代表登录大会官网，选择【汇款支付】，然后根据跳转出的账号进行支付。

3. 现场缴费

如无法采用扫码和汇款支付，可选择现场支付。选择该支付方式不享受优惠注册费金额，均按学生 1800 元，非学生 2800 元的注册费标准缴纳。

4. 汇款支付注意事项

- (1) 汇款时务必在用途一栏注明“注册号-姓名”，例：0001-姓名；
- (2) 优惠截止日期前注册并成功缴费的参会代表享注册费优惠政策；
- (3) 为便于大家及时领到发票，请尽量申请电子发票；
- (4) 如为汇款支付，缴费日期以银行电子回单汇款日期为准。

三、联系方式

1. 参会咨询

电话：010-68710443，闫老师 15712976428

邮箱：cmc_public@126.com

2. 财务咨询

电话：010-61196085、李老师 13520198012（微信同号）、

孙老师 13520675663（发票、汇款）

3. 论文咨询

电话：刘老师 15210936650、王老师 18519046547

4. 展览、赞助咨询

电话：王老师 15611013638

